

Title (en)

Centering device for the realization of the pin insertion of a multipin case.

Title (de)

Zentrierungsvorrichtung zur Durchführung des Stiftesteckens eines Mehrsteckstiftegehäuses.

Title (fr)

Dispositif de centrage pour la réalisation du brochage d'un boîtier multibroches.

Publication

EP 0228119 A1 19870708 (FR)

Application

EP 86202170 A 19861204

Priority

FR 8518471 A 19851213

Abstract (en)

[origin: US4741090A] Centering device for inserting pins in a multipin housing designed to receive an integrated circuit, whose pins are in the form of stems fitted with flat heads. The stem goes through a plane part, called the housing substrate, through holes which have first been metallized, with the pins protruding from one of the faces of the substrate by a length sufficient to ensure the fastening of the housing. The flat head bears upon the other face of the substrate via a metal preform of an alloy which is suitable for ensuring the fusion or melting for fastening the pins. This centering device consists of three parts. The first part is formed by a first metallic plate; the second part is formed by a second metallic plate used for calibrating the centering of the pins, said metallic plate being drilled with holes arranged in a geometrical pattern in compliance with the pattern chosen for the arrangement of the pins on the housing and calibrated so as to hold and to center the stems in the housing holes. The third part consists of a gripping device to lock the substrate of the housing fitted with its pins on the first metal plate. The materials chosen for the first metal plate have an expansion coefficient close to the expansion coefficient of the substrate of the housing in the temperature range at which the pins are to be fastened and this first metal plate is locked to the substrate of the housing during the fastening of the pins. Only the first metal plate is brought to this fastening temperature.

Abstract (fr)

Dispositif de centrage pour la réalisation du brochage d'un boîtier multibroches, boîtier destiné à recevoir une plaquette de circuit intégré, et dont les broches présentent la forme d'une tige munie d'une tête plate, la tige traversant une partie plane dite support du boîtier dans des trous préalablement métallisés et dépassant d'une des faces du support d'une longueur suffisante à assurer la fixation du boîtier, et la tête plate prenant appui sur l'autre face du support par l'intermédiaire d'une préforme métallique en un alliage propre à assurer par fusion la fixation des broches, ce dispositif de centrage étant caractérisé en ce qu'il est constitué de trois parties, la première partie étant formée d'une première plaque métallique, la seconde partie étant formée d'une seconde plaque métallique servant de calibre de centrage des broches percée de trous disposés selon un motif géométrique conforme au motif choisi pour la disposition des broches sur le boîtier et calibrés de manière à assurer à la fois le maintien et le centrage des tiges dans les trous du boîtier, et la troisième partie étant constituée d'un dispositif de serrage pour réaliser le blocage du support du boîtier muni de ses broches sur la première plaque métallique, et en ce que les matériaux choisis pour réaliser la première plaque présentent un coefficient de dilatation proche de celui du support du boîtier dans le domaine de température où se fait la fixation des broches, cette première plaque métallique sur laquelle est bloquée le support du boîtier durant la fixation des broches, étant seule portée à cette température de fixation.

IPC 1-7

B23K 3/00; **H01R 43/20**

IPC 8 full level

H01R 12/04 (2006.01); **H01R 43/02** (2006.01); **H01R 43/20** (2006.01); **H05K 3/34** (2006.01)

CPC (source: EP US)

H01R 43/02 (2013.01 - EP US); **H01R 43/205** (2013.01 - EP US); **Y10T 29/49895** (2015.01 - EP US); **Y10T 29/53961** (2015.01 - EP US); **Y10T 29/53978** (2015.01 - EP US)

Citation (search report)

- [A] GB 2106327 A 19830407 - TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO [JP]
- [A] US 3414962 A 19681210 - ALTAMURA JOSEPH A

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB

DOCDB simple family (publication)

EP 0228119 A1 19870708; **EP 0228119 B1 19910403**; DE 3678547 D1 19910508; FR 2591810 A1 19870619; FR 2591810 B1 19880219; JP H0752665 B2 19950605; JP S62145677 A 19870629; US 4741090 A 19880503

DOCDB simple family (application)

EP 86202170 A 19861204; DE 3678547 T 19861204; FR 8518471 A 19851213; JP 29505086 A 19861212; US 93764086 A 19861203